

薄化ウェハデマウンター SDK-300

・薄化ウェハを「割らない」「欠けない」「傷つけない」剥離装置



・ウェハに優しいコンタクト

吸着ヘッドがエアを逆噴射する等、ソフトランディングしますので、ウェハに負荷を与えないコンタクトが可能になりました。

・「割らない」「欠けない」「傷つけない」剥離動作

ウェハを斜め上方向に剥離させていくので、ウェハに優しく、パターン面にも一切のダメージを与えることなく剥離出来ます。

・エッジコンタクトによるウェハリリース

剥離されたウェハをリリースする際、リリースステーションでエッジコンタクトによって受けるので、パターン面に接触することはありません。

・上下独立ヒーター機構

吸着ヘッド側とヒーターステージ側の各ヒーターは独立した温度設定が可能です。また300℃まで昇温できるので高温溶解タイプのWAXにも対応できます。

・省スペース化

コンパクト設計で事務机ほどのフットプリントを実現しました。

・対応ウェハ

SiC、GaN、GaAs、Si、サファイア等、硬くて、脆いウェハも剥離可能です。



標準仕様	
対応ウェハサイズ	φ2"~φ6"
X軸ユニットストローク	190 mm
Z軸ユニットストローク	50 mm
ヒーター温度	~300℃
吸着ヘッド用ヒーター	2,000 w
ヒーターステージ用ヒーター	2,500 w
真空ポンプ (2基)	(1基) 200 w
重量	500 kg
エア	0.4~0.6 MPa
機械寸法	W: 800 mm D: 1,100 mm H: 1,500 mm